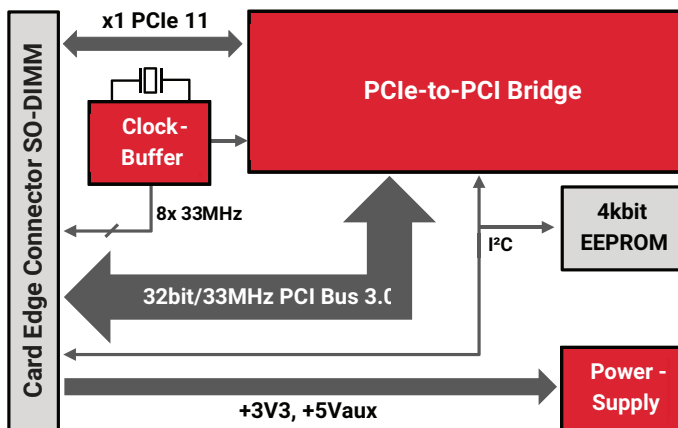


PCIe-PCI 桥接模块

nVent SCHROFF PCIe-to-PCI 桥接模块依据PCI Express-to-PCI Specification 1.0规范设计,性能卓越.该模块使应用程序能够将传统并行PCI总线接口迁移到新一代串行PCI Express接口.该模块配置一个PCI Express x1端口和一组并行总线端口,可同时连接多达8台PCI主机,基于PCI规范的通信



产品主要功能

- 使PCIe总线能够兼容运行传统PCI设备
- 通过桥接模块(支持信号直接传输)实现以上功能
- 支持3.3V及5V工作电压
- 设备支持在宽温环境下工作,适用于多种应用
- 规格小巧,功耗较低



主要性能指标	PCIE-PCI 桥接模块
I/O 控制器	Diodes Incorporated - PI7C9X112SL
接口数量	支持最高 x8 PCI Masters
总线-1	x1 PCI Express Base总线, 兼容PCI Express Specification R1.1规范
总线-2	33MHz/32bit PCI Local Bus, 兼容PCI Local Bus Specification R3.0规范
模块带宽	133 MByte/s
工作电压	+3.3 V +/- 5% 250 mA
	+5.0 V +/- 5% 75 mA
功耗	标准 700mW 最高 1200mW
连接器型号	SO-DIMM板端连接器
内部接口	4kbit SPI-EEPROM, JTAG, I ² C / SMBUS
外形尺寸(长x宽x高)	67.6mm x 30.0mm x 4.5mm
MTBF (平均无故障工作时间)	> 3,500,000 hours (40°C 环境温度下)
环境要求	工作温度 -40°C ~ +85°C
	储存温度 -65°C ~ +150°C
	湿度 20-80%, 无凝露



订货信息

物料号

PCIe-PCI 桥接模块,8槽

23297-365

获得更多产品信息,请访问:

LP.SCHROFF.NVENT.COM/EN/PXI-EXPRESS